**003\_반도체의 형태**

1. Wafer

- Silicon(Si)을 재료로 만든 둥근 원판 → 모래를 구성하는 대부분의 성분이 Silicon

- 한 장의 Wafer에 수많은 사각형의 Chip을 만듦

- Wafer 가장자리의 불완전한 사각형 Chip은 제조 불가 → Wafer의 지름은 300mm(12 inch),

200mm(8 inch)가 있음

- 크기가 커질수록 가장자리 유효 Chip 증가 → 생산성 증가

2. Chip

- 조립 공정을 거쳐 반도체 제품으로 되는 최소 크기의 조각

- 실제로 업계에서는 Die라는 표현을 더 많이 사용

- Net Die(Gross Die)는 한 장의 Wafer에서 나올 수 있는 유효 Die 수

3. Module

- 여러 개의 Chip을 작은 인쇄 회로 기판(PCB) 위에 장착한 형태

- JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council) 국제표준 준수

- PC나 서버를 만드는 세트 업체가 Module 단위로 호환하여 사용

4. Wafer - Chip - 집적회로

